

证券代码： 600601

证券简称： 方正科技

方正科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-0401

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 时间 | 2024 年 4 月 2 日-4 月 16 日 |
| 地点（方式） | 线上电话会议交流 |
| 参与单位（或人员） | 易方达基金、华安基金、华宝基金、民生加银基金、鹏扬基金、万家基金、海富通基金、光大保德信基金、财通基金、信达澳亚基金、宝盈基金、泰康基金、广发基金、东北证券、财通电子 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：梁加庆 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>调研会议互动问答的主要内容如下：</p> <p>问：2023 年公司全年业绩表现情况。</p> <p>答：在 PCB 市场下行、需求疲软的不利行业环境下，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的市场发展理念，主攻国内大客户市场，积极开拓国外等新兴市场。推进精细化管理，全面降本增效，保障了公司经营健康稳健运行。公司实现营业收入 31.49 亿元，</p> |

同比下降 35.59%，系 2022 年末剥离方正宽带及方正国际业务所致；归属于公司股东的净利润 13,507.72 万元，上年同期数为-42,354.25 万元，同比扭亏为盈。其中，公司 PCB 业务实现营业收入 30.22 亿元，实现净利润 1.78 亿元。

问:2024 年公司经营目标。

答：2024 年是落实“十四五”规划的关键之年，更是公司践行战略规划、深挖发展潜能的冲刺之年。更加聚焦 PCB 主业，推进产能扩建工作，全面提升产品技术、质量及运营能力，保持 PCB 核心业务的稳定增长，确保公司高质量发展。

一是 PCB 业务按照既定新发展战略，不断加强经营管理水平，积极应对行业竞争，努力提升经营效益。

二是从战略角度拓展发展空间，推进“产融结合”充分发挥控股股东战略赋能优势，依托股东的优势资源，重点围绕资本资金、市场拓展、上下游产业链等方面，积极筹划并寻求进入强势产品领域的机会，做强优势领域，拓宽产品品类，服务客户并增加客户黏性，加速公司实现升级转型。

问:公司 2023 年现金分红政策的执行情况。

答：2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2022 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。2024 年 3 月 28 日，公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。公司 2023 年度利润分配预案尚需要公司股东大会审议。

问：珠海华发集团有限公司对公司是否提供支持？

答：珠海华发集团有限公司作为公司间接控股股东，将重点围绕资本运作、市场拓展、上下游产业链整合等予以支持，加速公司实现升级转型。

问：胜宏科技（惠州）股份有限公司参与公司重整, 双方是否有合作？

答：公司与胜宏科技（惠州）股份有限公司均为独立的经营主体。

问：目前公司 PCB 产品的行业地位如何？

答：公司产品主要包括 HDI、多层板（2-56 层）、软硬结合板和其它个性化定制 PCB 等。公司经过数十年来的发展在高多层板和 HDI 领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、数字能源、汽车电子和工控医疗等产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。在 CPCA 发布的 2022 中国电子电路行业排行榜，公司 PCB 业务规模排在综合 PCB 厂商第 25 名，内资 PCB 厂商排名第 11 名。

问：公司 PCB 各类产品技术水平如何？

答：经过数十年来的快速发展，通过现有技术改造和扩大产能紧跟国内核心客户技术需求，公司目前技术能力已达到行业先进水平。公司技术发展方向聚焦行业 PCB 新材料和前瞻性新技术研发，PCB 信号完整性及散热方案，翘曲仿真等研究。公司致力提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。与国内通讯行业领军企业建立长期深度合作，同步展开多个 5G 主板及天线板 PCB 的研

发项目；成功开发出 FVS，将 PCB 损耗控制和布线密度提升到更高的水平；开发出 Z-向互联技术，实现了多 PCB 的堆叠互联，有助于超高厚径比和局部高密复杂设计的产品的制作；其他特色工艺如 Cavity、UHD、阶梯金手指、特殊散热、能源厚铜和高端光模块等皆已量产，助力客户在研发 N+1 和 N+2 代产品中带来设计、成本和制作周期的优势，不断追求卓越水平。

问：请介绍下分产品的产能分布情况。

答：公司目前在运营的共有 4 间工厂，原总设计产能是 185 万+平方英尺/月，目前正投资约 9.43 亿元人民币在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目。

问：公司 PCB 业务未来扩产方式有哪些？

答：扩产方面，公司已分别投资 6.896 亿元建设 F7—二期高阶 HDI 项目、投资约 9.43 亿元在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，同时，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平，高端 HDI 产能稳步提升，F3 工厂—HDI 高阶产能、高阶面积占比双提升，布局完成了 MSAP 产线等。此外，在 PCB 领域积极寻找与公司 PCB 业务在市场、品类、技术等能够资源互补的标的，探求战略并购。

问：二期高阶 HDI 项目目前进展？

答：2023 年 6 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露了《方正科技集团股份有限公司关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的公告》（公告编号：临 2023-048），公司拟投资 6.896 亿元建设 F7 二期高阶 HDI 项目，该项目投产后将增加 11.5 万平方英尺/月产能。公司已制定严密的进度总控制计划，2023 年已投入 1.764 亿元，目前正在按照正常计划推进，预计 2024 年 5 月底能够完工。

问：公司 HDI 产品的销售情况？

| | |
|--------|--|
| | <p>答：目前，在 HDI 产品领域的客户梯队完善，现有客户订单良好，从中长期市场发展趋势看，消费电子及车载产品等市场需求稳定，未来可持续发展基础良好。。</p> <p>问：公司 PCB 产品应用领域方面的情况如何？</p> <p>答：公司 PCB 业务布局了七大 PCB 的应用领域（通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、数字能源、汽车电子、工控/医疗）。目前主要以通讯设备和消费电子领域业务为基础，加速扩大光模块、服务存储、数字能源领域业务的市场份额，积极布局并重点突破汽车电子、工控医疗领域等业务。</p> <p>问：公司 PCB 产品是否能应用在服务器存储和光模块领域？</p> <p>答：公司 PCB 业务有产品供应于客户服务器业务和光模块。</p> |
| 附件（如有） | 无 |
| 记录时间 | 2024 年 4 月 16 日整理 |